



ICEP-IAAC2025 開催報告

2025.7.24

ICEP-IAAC2025 組織委員会

【会議詳細】

名称：2025 International Conference on Electronics Packaging
joined with iMAPS All Asia Conference

開催日時：2025 年 4 月 15～18 日

開催会場：若里市民文化ホール（日本国長野県長野市）

登録人数：964 人（日本国内 730 名、海外 234 名；17 の国と地域）

発表件数：237 件（IAAC 7 件、Keynote 5 件、口頭発表 181 件、ポスター発表 44 件）

Financial sponsors：38 社

Sponsor：一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

Technical Co-Sponsors：IEEE EPS, IEEE EPS Japan chapter, iMAPS, SMTA

Joint conference：iMAPS All Asia Conference(IAAC)

Venue of welcome reception：ホテル メトロポリタン長野

【組織委員会】

General Chair：Taiji Sakai, TSMC Japan 3DIC R&D Center

General Vice Chair：Takaaki Ishigure, Keio University

Yasuhiro Morikawa, ULVAC

Ryo Endo, Rapidus

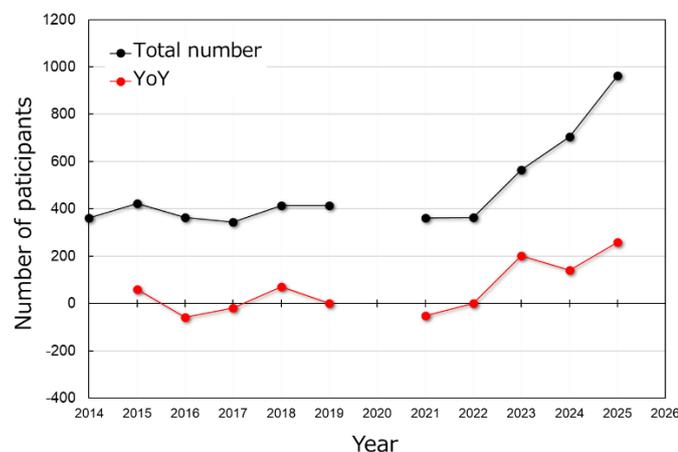
Technical Program Committee：47 members

Operation Committee：31 members

International Technical Committee：6 members

Advisory：10 members

【参加者数推移】



【開催概要】

ICEP(International Conference on Electronics Packaging)は、1980年に開催された、前身となる大会(IMC)から今回で46年目を迎え、2025年4月15日から18日に長野県長野市で開催されました。2018年以来のiMAPS All Asia Conferenceとの合同開催となり、多くの参加者にご来場いただき、大盛況のうちに閉幕しました。参加登録人数は過去最高の964人(日本国内730人、日本以外17の国と地域から234人)、前回比259人の大幅増となりました。



会場の若里市民文化ホール

【IAAC Special Session】

ICEPは今回、IMAPS All Asia Conference(IAAC)とのジョイント開催年にあたる事から、IMAPS Past presidentのBeth氏(Zero ASIC)とIMAPS global collaboration meetingメンバーと連携し、2025年4月15日午後に「3D Chiplet Technologies for Automotive / AI Applications」と題し、IAACスペシャルセッションを開催しました。冒頭、日本国経済産業省の金指氏に日本の半導体投資の最新状況について講演をいただきました。以降、各国から7名の著名な講師の方々を招き、ご講演をいただきました。



IAAC Special sessionの様子

【ICEP 講演サマリー】

エレクトロニクス実装技術に関する最新の研究成果について議論され、AI の製造工程への応用、低温はんだ接合、Cu-Cu 接合、ガラス基板技術、先端パッケージング、サーマルマネジメントなど、幅広いテーマが扱われました。AI 応用では、プリント基板の自動光学検査 (AOI) における活用が紹介され、製造工程の効率化が議論されました。低温はんだ接合では、Sn-Bi 系や Sn-In 系合金の熱機械特性、濡れ性、信頼性評価が報告され、微細化や低温化への対応が進んでいます。Cu-Cu 接合では、ナノツイン Cu やナノ結晶 Cu を用いた低温接合技術、表面処理や光活性化による接合強度向上が注目されました。ガラス基板技術では、TGV 加工、Cu めっき、スパッタ成膜、密着性向上などのプロセス開発が進められており、ガラス基板の実用化に向けた課題と展望が示されました。先端パッケージングでは、3D 実装、ヘテロジニアスインテグレーション、ハイブリッド接合、Fan-Out 構造などが取り上げられ、信頼性評価や反り抑制技術が紹介されました。サーマルマネジメントでは、高熱伝導材料 (Cu ナノ粒子、ダイヤモンド複合材など) や冷却技術 (二相冷却、空冷、TIM の界面熱抵抗評価) が報告され、高性能デバイスの熱制御に向けた取り組みが進んでいます。さらに、光電融合技術では、シリコンフォトニクスとポリマー導波路の接続、CPO 対応コネクタ設計、光モード評価手法などが紹介され、次世代通信技術への応用が期待されています。各セッションでは、産学官の連携による技術開発が活発に行われ、聴講者との質疑応答も盛況でした。特に、ガラス基板、ハイブリッド接合、自動化技術に関する発表は高い関心を集め、ICEP が国際的な技術交流の場として重要な役割を果たしていることが示されました。



講演会場の様子

【Welcome reception】

4/16 に開催された Welcome reception では、冒頭に荻原健司 長野市長からご挨拶をいただき、壇上 関係者が「鏡割り」セレモニーを行いました。会の途中には、風間神社太々神楽保存会の方々による「獅子舞」が披露されました。会場では長野の特産である各種の日本酒が振舞われ、700 名を超える参加者が懇親を深める場となりました。



荻原健司 長野市長 ご挨拶



鏡割りセレモニー



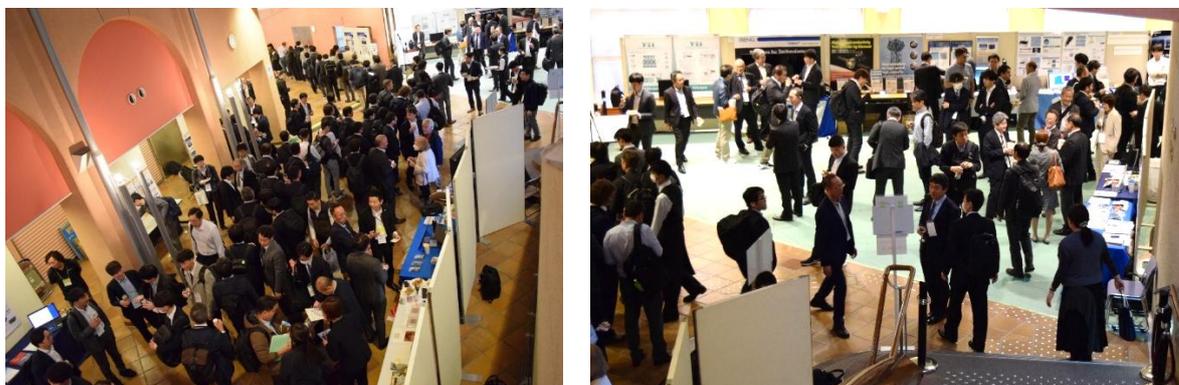
乾杯の音頭



獅子舞披露

【企業展示】

開催期間中、会場内展示ブースにて 32 の企業および団体が半導体関連事業についての紹介を行いました。4 月 17 日夕刻には展示エリアで立食パーティーが開かれ、参加者は説明員と気さくな議論を交わし、後半は恒例のビンゴゲームを楽しみ、大いに盛り上がりました。



展示会場の様子

【授賞式】

ICEP2024 の優秀論文賞 4 件、ポスター賞 2 件および IEEE EPS Japan Chapter Young Award 5 件の表彰式が行われました。



授賞式後 記念撮影

【次回予告】

次回は 2026 年 4 月 14 日から 17 日に日本の広島県広島市で開催されます。IEEE EPS Hybrid bonding symposium との共同開催です。関係者一同、念入りに準備を行っております。今年以上に良い大会とすることをお約束いたします。数多くの皆様のご参加をお待ちしております。詳しい情報は ICEP の web site をご覧ください。

Web site へのリンク：<https://www.jiep.or.jp/icep/>